プラスチック上への薄膜転写プロセスの開発

的場彰成* 奥谷潤* 筒口善央* 米澤保人* 中田祐次郎** 松岡樹** 川江健** 森本章治**

チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)は優れた圧電特性を示す材料して知られているが、その作製には高温プロ セスが必要である。そのため、樹脂や衣服などの耐熱温度が低い基材の上に作製することができない。こ れが解決できれば、例えば脈拍などのメディカル情報の測定機能を持たせた衣服の開発に繋がる。そこで 本研究では、500°C以上の高温プロセスが必要なPZT膜を耐熱温度が200°C以下のプラスチック上に作製す るPZT薄膜の転写プロセスを検討し、PZT膜の剥離に酸化カルシウム(CaO)及び酸化マグネシウム(MgO)の 潮解性を利用することで、プラスチック上にPZT膜を形成する方法を確立した。

キーワード: 転写, 潮解性, チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)

Development of Transfer Process of Film onto the Plastic

Akinari MATOBA, Jun OKUTANI, Yoshiteru DOUGUCHI, Yasuto YONEZAWA, Yujiro NAKADA, Tatsuru MATSUOKA, Takeshi KAWAE and Akiharu MORIMOTO

Although it is known that lead zirconate titanate (PZT) has superior piezoelectric properties, a high temperature fabrication process is required for its fabrication. Therefore, PZT can not be fabricated on the substrate with low heat resistance, such as plastic, and textiles. If this problem is solved, for example, it leads to the development of the clothes with the function measuring medical information, such as a pulse. In this study, we studied the transfer process which PZT film fabricated in more than 500 degree fabricated on the plastic substrate of 200 degree or less heat-resistant temperature. Then, deliquesce of calcium oxide and magnesium oxide are used for the transfer of PZT film. As a result, it is established the process which PZT film fabricates on the plastic substrate.

Keywords : transfer, deliquesce, lead zirconate titanate (PZT)

1. 緒 言

チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)は、優れた圧電特性を 持つことから圧電センサとしてよく用いられる。しか し、十分な圧電特性を得るために作製には500°C以上 の高温プロセスが必要であり、これまで耐熱温度が 200°C以下の樹脂基板や衣服の上に作製することはで きなかった。もし耐熱温度の低い基板上に作ることが 可能となれば、例えば衣服に人体の心拍数や体温など のメディカル情報を測定する機能を付加することが可 能となる等、医療分野を中心に開発が望まれている。

そこで本研究では、潮解性を持つ酸化カルシウム膜 (CaO)及びアモルファス酸化マグネシウム(a-MgO)膜を PZT膜と基板との中間層として用いることで、耐熱温 度200°C以下のプラスチック基板上に500°C以上の高温 プロセスが必要なPZT膜の形成を可能とする薄膜転写 プロセスを検討した。

2. 作製及び測定方法

2. 1 PZT膜の作製

パルスレーザ堆積(PLD)法¹⁾にて,Si基板上に PZT/STO/CaO及びPZT/STO/a-MgOを作製した。各層の 作製条件を表1に示す。膜厚はCaOを1µm及び20µm, a-MgOは1µm,PZTは1µmとした。チタン酸ストロン チウム(STO)はPZT作製のためのバッファ層である²⁾。 CaO及びMgOは潮解性を持つため純水に曝すことによ ってPZT膜をSi基板から剥離させることが可能となる。 形態観察及び結晶構造解析には潮解性の高いCaO,電 気特性測定にはPZT薄膜作製時に用いられるa-MgOを 用いたサンプルを使用した。

*電子情報部 **金沢大学

ターゲット	CaO	a-MgO	STO	PZT
堆積温度(°C)	600	600	600	600
レーザエネルギ ー(mJ)	150	150	150	150
繰り返し周波数 (Hz)	5, 20	10	5	5
堆積時間(min)	48, 550	100	10min (CaO) 10shot (a-MgO)	100
堆積雰囲気(Torr)	O ₂ :0.1	O ₂ :0.1	O ₂ :0.1	O ₂ :0.3
徐冷雰囲気(Torr)		O ₂ :10	O ₂ :10	O ₂ :10

表1 PZT/STO/CaO or a-MgOの作製条件

2. 2 転写プロセス

プラスチック上へのPZT膜の転写を行ったプロセス は以下のとおりである。模式図を図1に示す。

- ①表1に示した条件によりSi基板上にPZT膜を作製す る。
- ②両面テープ(ニチバン㈱社製 ナイスタック)を用 いて、 治具(Si)をPZT表面に 接着する。
- ③純水に浸漬させ、CaOを潮解させることでSi基板 からPZT膜を剥離させる。
- ④スピンコートを用いてワニス(宇部興産㈱社製 U-ワニス)を塗布したプラスチック基板(東洋プラス チック精工㈱社製 R1000)上にPZT膜を固定する。 その後200°C、4時間で熱処理することで接着させ る。
- ⑤アセトンを用いて両面テープを溶解し、治具を PZT膜から剥離させる。



2.3

測定方法

実用化のためには図1のプロセス③においてPZT膜 の剥離時間をできるだけ短くし製造工程にかかる時間 の短縮が求められる。また、転写の前後において、 PZT膜の特性が変化していないか調査する必要がある。 そこで、剥離時間短縮を検討し、形態観察、結晶構造 解析、電気特性測定によってPZT膜の変化を調査した。

作製したサンプルの表面及び断面観察には走査型電 子顕微鏡(JEOL㈱社製 JSM-7001F), 元素分析にはエ ネルギー分散型X線分析(JEOL㈱社製 JED-2300F)を 用いた。断面試料作製にはイオンミリング(JEOL㈱社 製 SM-09010)を用いた。PZT膜の結晶構造の確認に は、X線回折(XRD)装置(ブルカーエイエックスエス㈱ 社製 D8DISCAVER)を用いた。電気特性測定には強 誘電体評価システム(㈱東陽テクニカ社製 FCE-3 金 沢大学にて実施)を用いた。

3. 測定結果

Si基板からの剥離時間 3.1

治具がない状態でPZT膜を室温で純水に浸漬した場 合、PZT膜は短時間で剥がれるが、水中に四散し保持 できなかった。そこで当初はワックスなどの接着剤を 用いて治具と接着したが、純水の浸透が阻害され、純 水漬後のSi基板からの剥離ができなかった。そこで, 純水が浸透しやすい両面テープを用いてPZT膜を治具 に貼り付けて浸漬させた。そのときに必要とした時間 を表2に示す。CaOの厚さが1µmのとき, CaO-PZT間の 剥離まで480時間以上かかった。そこで、治具がない 状態で0.5時間程度純水に浸漬した後に治具を接着し、 再度浸漬させた。さらに薄膜側面から純水が浸透する と考えられるため、CaOの厚さを20µmと厚くすること で浸透を促進し剥離時間の短縮を図った。その結果, 剥離にかかる時間を2時間に減少させることができた。

表2 PZT膜の剥離時間

		治具なし	治具あり		
			最初から	途中から※	
CaO	1µm	24時間	>480時間	-	
厚さ	20µm	1時間	144時間	2時間	

治具なしで純水中に0.5時間浸漬後,治具に接着して 再度1.5時間純水中に浸漬

図1 プラスチック上へのPZT膜の転写プロセス



3.2 形態観察と結晶構造解析

図2に各プロセスで作製した試料表面断面の光学, 電子顕微鏡(SEM)写真を,図3に断面のSEM写真を示 す。図2(a),3(a)は図1①の表面,図2(b),3(b)は図1③の 剥離面,図2(c),3(c)は図1⑤の表面の観察結果である。 断面観察画像(図3)では,元素分析結果から得られた 各層を表記する。

PZT/STO/CaO/Si(図2(a))とPZT/テープ/治具(図2(b))の 電子顕微鏡画像より、プロセスによって表面形状が異 なっていることが分かる。これはPZT/テープ/治具の 断面SEM写真(図3(b))から、PZT膜をSi基板から剥離さ せた後も剥離面にCaO膜が10µm程度残っているためで ある。また、PZT/ワニス/プラスチックでは両面テー プと思われる繊維形状が見られる(図2(c))。図3(c)に示 すとおり、転写後のPZT/ワニス/プラスチックの試料 では厚さ1µm程度のPZT膜が残っていることが分かる。 図4に各プロセスのX線回折の結果を示す。各プロセスは図2,3と同じである。図4(b)における28^o付近のピークは両面テープによるものである。

図4(a)より,Si基板上にPZTが結晶化していること が分かる。図4(c)において縦軸のX線強度が減少して いるのは,図2(c)及び図3(c)の表面及び断面解析で示 したようにサンプル表面に両面テープが残っているた めだと考えられる。プラスチックへ転写後もPZT膜の 回折パターンに変化は認められなかった。また両面テ ープは超音波特性に対して影響はないと考えられる。

以上の結果より、プラスチック上にPZT膜が形成さ れていることが確認できた。

3.3 電気特性

電気特性を測定するにあたって、本研究においては CaOでは両面テープの残渣の除去などが完全にできな かったため、治具及び両面テープを用いずに転写した





図5より最大印加電圧800kV/cmにおける残留分極値



P_r及び抗電界2E_cはそれぞれ60μC/cm², 62kV/cm程度で あった。剥離前後において誘電特性に変化はなく,膜 質に変化がないことが分かった。

4.結 言

潮解性を持つCaO膜を用いることでプラスチック上 にPZT膜を転写する方法を検討し,以下の結果を得た。 (1)CaOの厚さを20μmとし,治具に接着する前に室温 で純水に浸漬させることで,剥離時間を2時間に短 縮することができた。

- (2)治具との接着に両面テープ,プラスチックとの接着 にワニスを用いることで転写が可能となった。
- (3)結晶構造解析から転写後の結晶構造の変化は少ない ことが分かった。また、潮解性をもつa-MgOを用い た場合の誘電特性の結果から、電気特性に関しても 劣化はないことを確認した。

謝 辞

本研究を遂行するに当たり,終始適切なご助言,ご 助力を頂いた岡山大学 神田氏,金沢工業大学 池永 氏,澁谷工業(株) 佐々木氏に感謝します。

参考文献

- 1) 電気学会.レーザーアブレーションとその応用.コロナ 社, 1999. 366p.
- S. Takahara, A. Morimoto, T. Kawae, M. Kumeda, S. Yamada, S. Ohtsubo, Y. Yonezawa. Thin Solid Film. 2008, 516, p. 8398.